

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 529

Общие данные

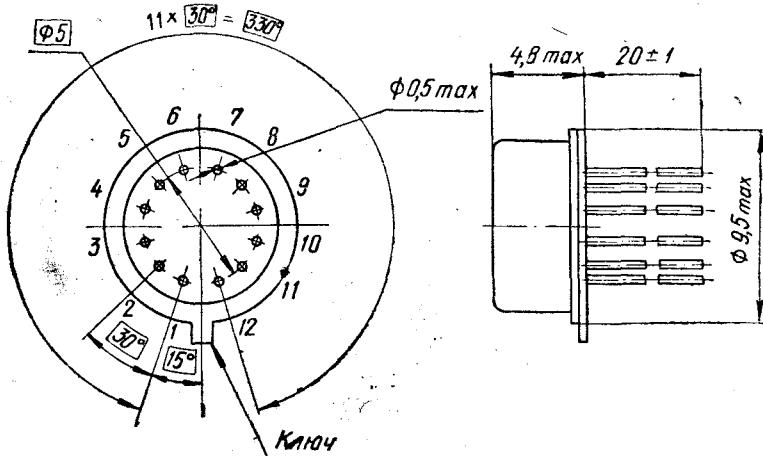
Микросхемы серии 529 предназначены для построения экономичных звеньев активных фильтров микросборок, блоков и аппаратуры.

Состав серии 529

Сокращенное обозначение вида микросхемы	Функциональное назначение	Номер технических условий
529УП1	Микросхема для построения активных фильтров	6К0.347.025 ТУ

Микросхема выполнена в круглом металлокерамическом корпусе 301.12-1.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



Масса не более 1,14 г

Смещение осей выводов от номинального расположения контролируется в плоскости основания корпуса.

Предельные отклонения угловых размеров между осями базового вывода и любого другого $\pm 4^\circ$.

Нумерация выводов показана условно.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вибрация:

диапазон частот от 1 до 5000 Гц
ускорение до 40 g

Многоократные удары:

ускорение до 150 g
длительность удара от 1 до 3 мс

Одиночные удары:

ускорение до 1000 g
длительность удара от 0,2 до 1,0 мс

Линейные нагрузки:

ускорение до 500 g
Температура окружающей среды от минус 60 до +85° С
Атмосферное давление от 5 мм рт. ст. до 3 атм

Иней, роса.

Соляной туман.

Среда, зараженная плесневыми грибами.

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка* 15 000 ч
Срок сохраняемости* 15 лет

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ОСТ В 11 073.041—80 и требованиями, изложенными ниже.

При эксплуатации должна быть предусмотрена защита микросхемы от случайного кратковременного увеличения питающих напряжений.

Монтаж микросхем следует вести с принятием мер, исключающих повреждение микросхем из-за перегрева и механических усилий.

При монтаже микросхем рекомендуется использовать минимальную длину соединений между выводами микросхем и навесными элементами для уменьшения влияния паразитных связей.

Микросхемы устанавливаются на платы вплотную или с зазором не более 1+0,5 мм. Способы крепления микросхемы должны обеспечивать фиксированное положение как самой микросхемы, так и ее выводов.

Микросхемы в блоках аппаратуры рекомендуется покрывать лаком ЭП-730 ГОСТ 20001—75, обеспечивающим работоспособность микросхемы в условиях повышенной влажности, морского тумана, инея и росы. Количество слоев лака — 3.

Применять меры по защите микросхем от статического электричества по ОСТ В 11 073.062—76.

Запрещается подведение каких-либо электрических сигналов (в том числе шин «питание», «земля») к корпусу и незадействованным выводам микросхемы 3, 4 и 11.

* В условиях и режимах, допускаемых ОТУ или ТУ.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

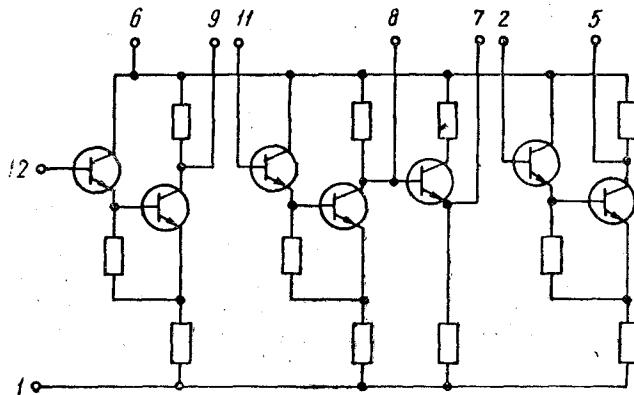
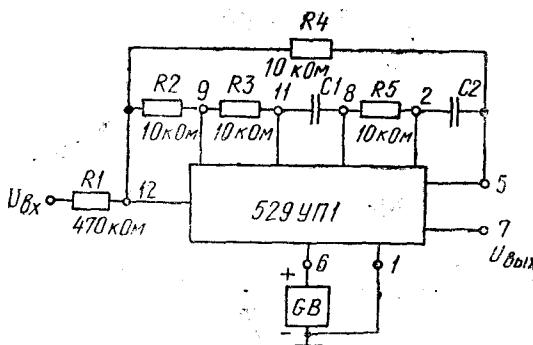


СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ



- | | |
|---------------|----------------|
| 1 — «земля» | 7 — выход |
| 2 — вход | 8 — выход |
| 3 — свободный | 9 — выход |
| 4 — свободный | 10 — свободный |
| 5 — выход | 11 — вход |
| 6 — +6 В | 12 — вход |

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре 25° С)

Напряжение питания	6 В ± 10%
Ток потребления	не более 3,0 мА
Коэффициент усиления каждого усилителя микросхемы (по напряжению) при $R_h = 15$ кОм; $f = 0,1$ МГц; $U_{bx} = 10$ мВ	не менее 40
Верхняя граничная частота каждого усилителя при $U_{bx} = 10$ мВ	не менее 0,5 МГц
Входное сопротивление каждого усилителя при $f = 1$ кГц; $U_{bx} = 10$ мВ	не менее 30 кОм
Выходное сопротивление каждого усилителя при $f = 1$ кГц; $U_{bx} = 10$ мВ	от 8 до 20 кОм